

SMD

额定电感1 μH 至1000 μH
额定电流0.18 A至3.45



施工

- 铁氧体磁芯
- 防磁
- 缠绕：漆包铜线
- 绕组焊接到接线端子

特点

- 温度范围可达125°C
- 高额定电流
- 低直流电阻
- 适用于无铅回流焊
- 基于AEC- Q200资格认证
- 符合RoHS标准

应用

- 电源电压滤波
- 耦合/去耦
- DC / DC转换器
- 工业电子产品
- 消费类电子产品

码头

- 基材CuSn6P
- 层组合物，镍，锡（无铅）
- 电镀

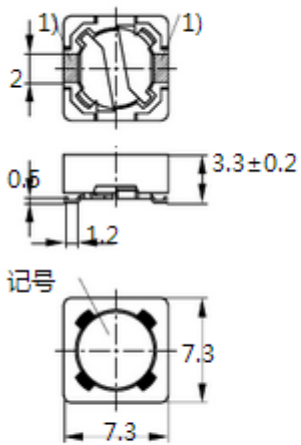
记号

- 基于组件的标记：
L值（ μH ，编码），
生产日期（YWWDD）
- 盘上最小的数据：
制造商，订货代码，L值，
填料的数量，日期

分装方式及包装设备

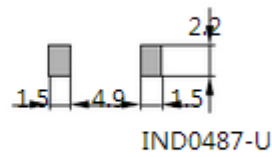
- 16毫米的泡裹带，缠绕在330毫米 \varnothing REEL
- 包装单位：1000个/卷

尺寸图和布局的建议



1) 焊接区

IND0486-L-E



IND0487-U

尺寸 (mm)
元件容差
另有说明。

±0.2 除非毫米

SMD
技术参数和测量条件

额定电感L	R	测量LCR测试仪安捷伦4284A在频率f 0.1 V, 20°C	L _r
额定温度T	R	85 °C	
额定电流I	R	马克斯。允许直流随温度的升高 在额定温度	≤40 K
饱和电流I	SAT	马克斯。允许DC与电感下降 $\frac{\Delta L}{L_0}$ 约. 10 %	
直流电阻R	最大	测得在20°C下	
焊 (无铅)		浸和外观的方法Sn95.5Ag3.8Cu0.7 : (245±5) °C, (5±0.3) s 润湿焊接区 ≥90% (根据IEC 60068-2-58)	
焊锡耐热性		260 ° C, 10秒 (根据IEC 60068-2-58)	
气候类别		55/125/56 (符合IEC 60068-1)	
储存条件 :		安装 : -55 °C ~ +125°C 包装 : -25 °C ... + 40 ° C, ≤75%RH下	
重量		约. 1.5克	